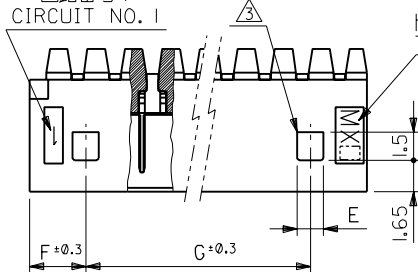
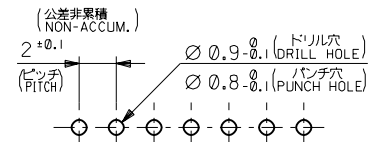
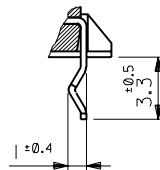
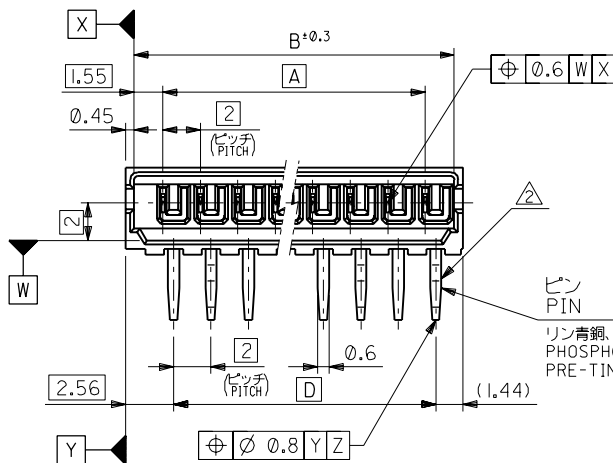
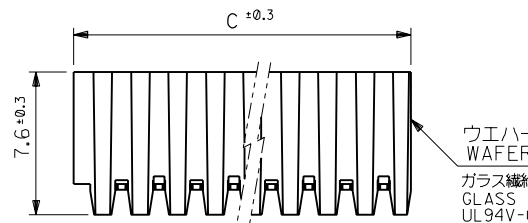
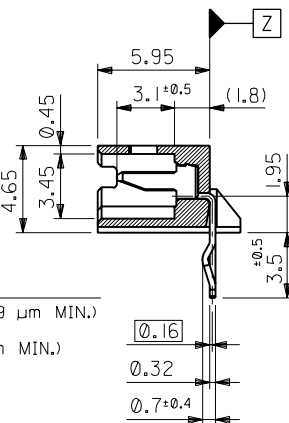


回路番号 1
CIRCUIT NO. 1トレードマーク
TRADE MARK2極品のキンク形態図
KINK FORM FOR 2 CKTS.両方のテールにキンクを施す。
SOLDER TAIL KINK SHOULD
BE ADDED ON BOTH TAILS.基板取付穴推奨寸法 (参考)
RECOMMENDED P.C. BOARD HOLE DIM. (REF.)
(t=1.6)

注記 NOTES

1. 嵌合相手 : 51004 シリーズ
MATES WITH : 51004 SERIES
2. 3極以上のキンクは、1極おきに2カ所以上に施すこと。
KINK TO BE ADDED ON THE ODD NUMBER
SOLDER TAILS.(FROM THE TRADE MARK SIDE)
3. ロック穴は、2極と3極は1カ所、4極以上は2カ所とする。
LOCKING HOLE : ONE PLACE FOR 2 AND 3 CKTS.
TWO PLACES FOR 4 AND MORE THAN 4 CKTS.

ピン
PINリン青銅、錫メッキ (0.9 μm MIN.)
PHOSPHOR BRONZE
PRE-TINNED(0.9 μm MIN.)ウェハー
WAFERガラス繊維入りナイロン66 (カラー : オフホワイト)
GLASS FILLED NYLON66 (COLOR:OFF-WHITE)
UL94V-0

26	3	1.4	28	32	31.1	28	53015-1510	15
24	↑	↑	26	30	29.1	26	↑ -1410	14
22			24	28	27.1	24	↑ -1310	13
20			22	26	25.1	22	↑ -1210	12
18			20	24	23.1	20	↑ -1110	11
16			18	22	21.1	18	↑ -1010	10
14			16	20	19.1	16	↑ -0910	9
12			14	18	17.1	14	↑ -0810	8
10			12	16	15.1	12	↑ -0710	7
8			10	14	13.1	10	↑ -0610	6
6	↓	↓	8	12	11.1	8	↑ -0510	5
4	3	1.4	6	10	9.1	6	↑ -0410	4
—H—	4	3.4	4	8	7.1	4	↑ -0310	3
—H—	3	1.4	2	6	5.1	2	53015-0210	2
G	F	E	D	C	B	A	ENG. NO.	極数 NO. OF CKTS.

角度 ANGLE	±3°
30 以上 OVER	±0.3
10 以上 30 未満 OVER	±0.25
10 未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

記号 LTR	再作図及び変更 REDRAWN & REVISED (JIS0279)	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
E	H.H. M.F.	'93/3/31		

材料 MATERIAL	図中参照 SEE DWG.
仕上げ FINISH	—H—
適用電線範囲 WIRE RANGE	—H—
被覆外径 INS. RANGE	—H—
DRAWN BY '93/3/31	CHK'D BY '93/3/31
H.HIRAMOTO	H.HIRAMOTO
APP'D BY '93/3/31	尺度 SCALE 4 - 1
M.FUKUSHIMA	

材料 MATERIAL	図中参照 SEE DWG.
仕上げ FINISH	—H—
適用電線範囲 WIRE RANGE	—H—
被覆外径 INS. RANGE	—H—
DRAWN BY '93/3/31	CHK'D BY '93/3/31
H.HIRAMOTO	H.HIRAMOTO
APP'D BY '93/3/31	尺度 SCALE 4 - 1
M.FUKUSHIMA	

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称

2.0 LOW PROFILE
WAFER ASS'Y R/ADWG. NO.
SD-53015-***10REV
E